证券代码：300223　　证券简称：君正股份

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20261112

投资者关系活动类别	■特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 □其他　（_____）
参与单位名称及人员姓名	摩根大通：韦安琪、高朕逸、刘叶；奇点资产：杨茉然；汇添富基金：钱晨润；高毅资产：朱春禹等
时间	2026 年 11 月 12 日
方式	现场交流会
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张敏
投资者关系活动主要内容介绍	**1、目前 DRAM 产能还是普遍偏紧，公司预计何时能够改善？** 公司 DRAM 产品主要由中国台湾地区的合作晶圆代工厂及 IDM 厂商供应。本轮存储周期中，原有长期协议的合作模式已根据市场情况调整，价格和数量均有变化，目前来看 2027 年产能仍较为紧张，公司正在积极争取更多产能，产能能否增长、增长多少存在不确定性。 公司目前存货仍比较高，其中 DRAM 存货占比较大，为保证客户的长期稳定供应，我们将结合生产及客户需求情况分配各季度出货，即便后续产能没有增长，也可保障持续供应至 2027 年底。根据代工伙伴 28 年的产能规划情况，公司正在积极争取 28 年能够获得更多的产能支持。 **2、DRAM 业务收入增长的主要驱动因素？** 今年 DRAM 产品的收入增长不仅来自价格上涨，也来自产品

	结构的升级。公司近两年来，一直在持续进行工艺制程的升级与产品迭代。公司新制程 DDR4、LPDDR4 产品今年一季度已经实现了规模销售，从而推动了 DDR4、LPDDR4 在 DRAM 中收入占比的明显提升，前三季度公司 DDR4、LPDDR4 在 DRAM 中的收入占比保持在 40%以上，但由于 DDR4、LPDDR4 产能非常紧张，收入占比的提升一定程度受到产能的限制。如果后续能够获得更多产能，DDR4 和 LPDDR4 占比有望继续提高，对收入增长的贡献也将显著提升。 **3、目前看到 NAND Flash 价格有所下调，公司是如何看的？公司在 NAND Flash 上有哪些布局和规划？** 在 NAND Flash 方面，因海外主要厂商已削减该领域产能，叠加终端需求旺盛，导致市场供给高度紧缺、价格年内涨幅较多；目前 NAND Flash 的产能仍然比较紧张，从车规市场来看，NAND Flash 的价格还是比较坚挺的，基本没有出现价格下调。 公司已在 SLC、MLC 等 NAND Flash 领域做了大量工作以进行产能储备，相关产能预计将于明年下半年或 28 年陆续释放并投入市场。 **4、NOR Flash 的市场应用场景是哪些？向海外客户供应存在困难吗？** NOR Flash 由公司全资子公司 ISSI 运营，其运营总部位于美国硅谷，因此在海外的销售不存在困难。公司 NOR Flash 产品主要面向汽车电子、工业等利基市场，合计占比大约百分之七八十，20%左右面向其他对品质和可靠性要求比较高的领域，如 AI 服务器、光模块、硬盘市场等，基本不供应大众消费品。 今年 NOR Flash 成长性良好，其中出货量的增长占了较大贡献，今年以来，公司在 AI 服务器和光模块领域的销售增长较快。为更好地满足这类高速增长的新兴市场需求，公司今年在国内组建了 NOR Flash 研发团队，面向新兴市场开展后续产品研发。公司已根据客户需求预订了明年的产能，明年公司 NOR Flash 产品线有望继续保持高速成长。

	5、供应商涨价对后续毛利率的影响大吗？公司如何看存储毛利率的后续走势以及公司存储业务的发展？ 今年公司产品调价可以覆盖成本上涨，预计全年存储芯片的毛利率有可能都是持续提升的。目前来看，明年一季度部分物料可能还会有一定的涨价。 从产业发展特点来说，存储产品的毛利率不可能一直上升，但具体什么时点毛利率会见顶，由于影响因素较多，目前也很难准确判断。长期来看，DRAM 领域，公司将通过新制程产品的持续研发迭代，以及后续争取新增产能，推动 DRAM 产品线持续成长，同时，公司积极布局面向端侧 AI 的 DRAM 产品，如 3D 堆叠 DRAM、Wide I/O DRAM 等产品，未来这些产品也有望推动公司 DRAM 产品线的长期持续发展。公司在 NOR Flash 和 Nand Flash 领域也在持续规划，不断加大研发投入，今年公司 Flash 业务的收入也有大幅增长，由于 NOR Flash 总体来说涨价幅度远小于 DRAM，因此 NOR Flash 的收入增长主要还是产业需求的推动。 **6、后续 DRAM 产品长协与调价机制如何安排？** 目前公司 DRAM 产品基本是按季度调价、按季度分货。由于 2027 年 DRAM 供应链预计仍然较为紧张，公司预计后续仍然会按季度定价以及按季度分货。 **7、3D 堆叠 DRAM 与 Wide I/O DRAM 的进展？** 3D 堆叠 DRAM 因对代工厂的产能资源占用较多，在现有 DRAM 供应链非常紧张的情况下，投片进度有所推后。Wide I/O DRAM 正与客户配合开发，投片进度预计早于 3D DRAM。 **8、计算芯片业务的情况？** 计算芯片主要面向消费市场，前三季度收入及毛利率持续提升，目前来看，后续毛利率有可能会有所回落，具体需视市场情况而定。为满足客户成本等各方面的需求，公司推出了不带 KGD 的产品，客户可以灵活地安排自己的产品规划，以应对 KGD 持续涨价带来的影响。从产品规划上，目前公司 4T 算力的产品已进行了 MPW 投片，预计明年量产投片；公司面向泛视觉领域的 C 系列产

	品已推向市场，目前在智能穿戴、笔记本电脑等领域正在积极进行推广，客户反映良好；此外，明年 AI-MCU 将开始量产销售，对计算芯片的收入也会是一个增量。 **9、模拟芯片业务情况？** 总体而言，模拟芯片产品线今年没有受到 AI 发展的强力推动，基本是基于公司自身产品线的不断丰富、市场的持续拓展、以及行业自身的发展等，收入保持了稳定增长的趋势。近年来，公司一直在加大研发，持续丰富模拟产品品类，除原有的 LED 驱动产品外，公司也在布局面向汽车智能系统及电源管理类的模拟产品，目前部分物料已开始贡献收入，部分客户处于定点导入阶段。此外，公司 GreenPHY 产品经过几年的客户导入，今年部分客户开始批量采购，目前看需求在不断增长。今年以来，模拟产品线的成本也有所增长，但前三季度公司模拟产品价格基本没有涨价，因此毛利率有一定波动，四季度起公司对部分产品上调了价格。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 12 日